



Eternal Materials Group



長廣精機

台新證券 

2026第三季全球投資論壇

2026.08.26

ETERNAL PRECISION MECHANICS

Safe Harbor Notice

本簡報所提供之資訊，係長廣精機股份有限公司(本公司)蒐集外部經濟發展現況並整合內部資料後所得，僅反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性，故實際營運結果將可能與預測性資訊有所差異。本公司不負有更新或修正簡報資料內容之責任，關於前瞻性看法將不會因任何新的資訊、未來事件或任何狀況的產生而更新。

Except for statements in respect of historical matters, the statements in this presentation are “forward-looking statements”. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual performance, financial condition or results of operations of the group of Eternal Precision Mechanics Co., Ltd. (EPM, including consolidated subsidiaries) to be materially different from any future such matters implied by such forward-looking statements. Investors are cautioned that actual events and results could differ materially from these statements as a result of a variety of factors, including conditions in the overall market and economy, acceptance and demand for products, and technological and development risks.

The audited financial statements included were prepared and published in accordance with TIFRSs as issued by the ARDF Taiwan

The financial forecasts and forward-looking statements in this release reflect the current belief of the group of EPM as of the date of this release and EPM undertakes no obligation to update these forecasts and forward-looking statements for events or circumstances that occur subsequent to such date.

目錄



01 長廣公司簡介

02 財務分析(2026H1-2025)

03 未來市場展望

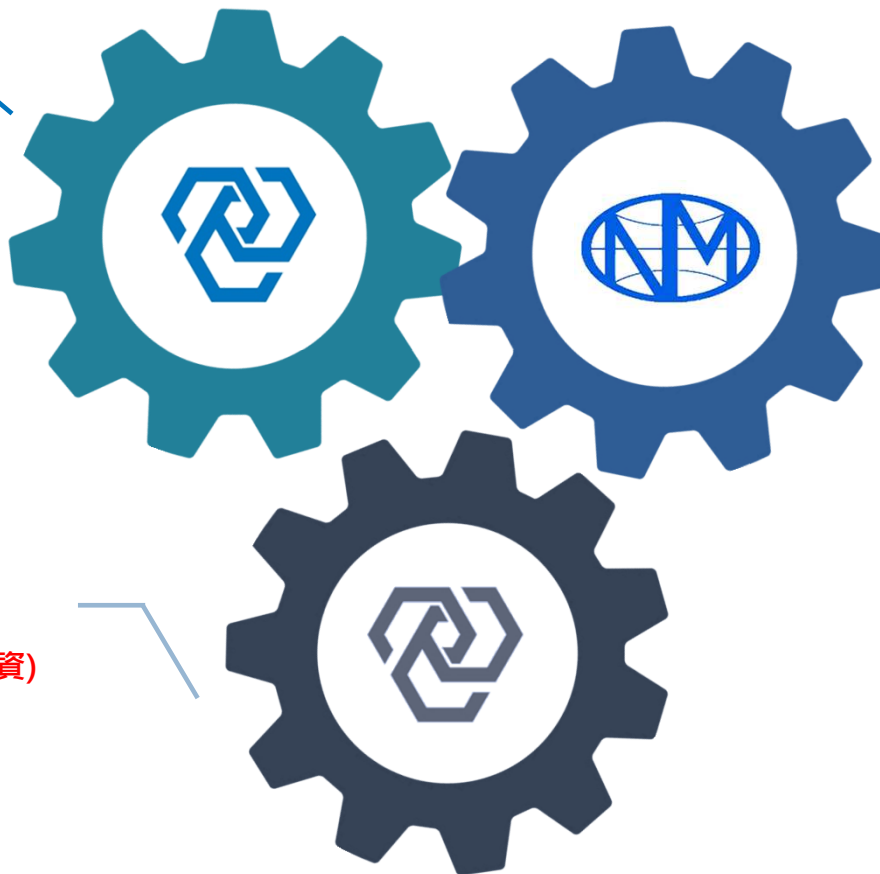
04 產能與重大資本支出規劃

05 先進封裝產業發展與產品開發

公司概況

■ 長廣精機股份有限公司

成立日：2022年10月21日
資本額：TWD 7.88億(已含IPO增資)
董事長：廖恒寧
總經理：岩田和敏
員工數：50名



■ Nikko-Materials株式會社 (NM)

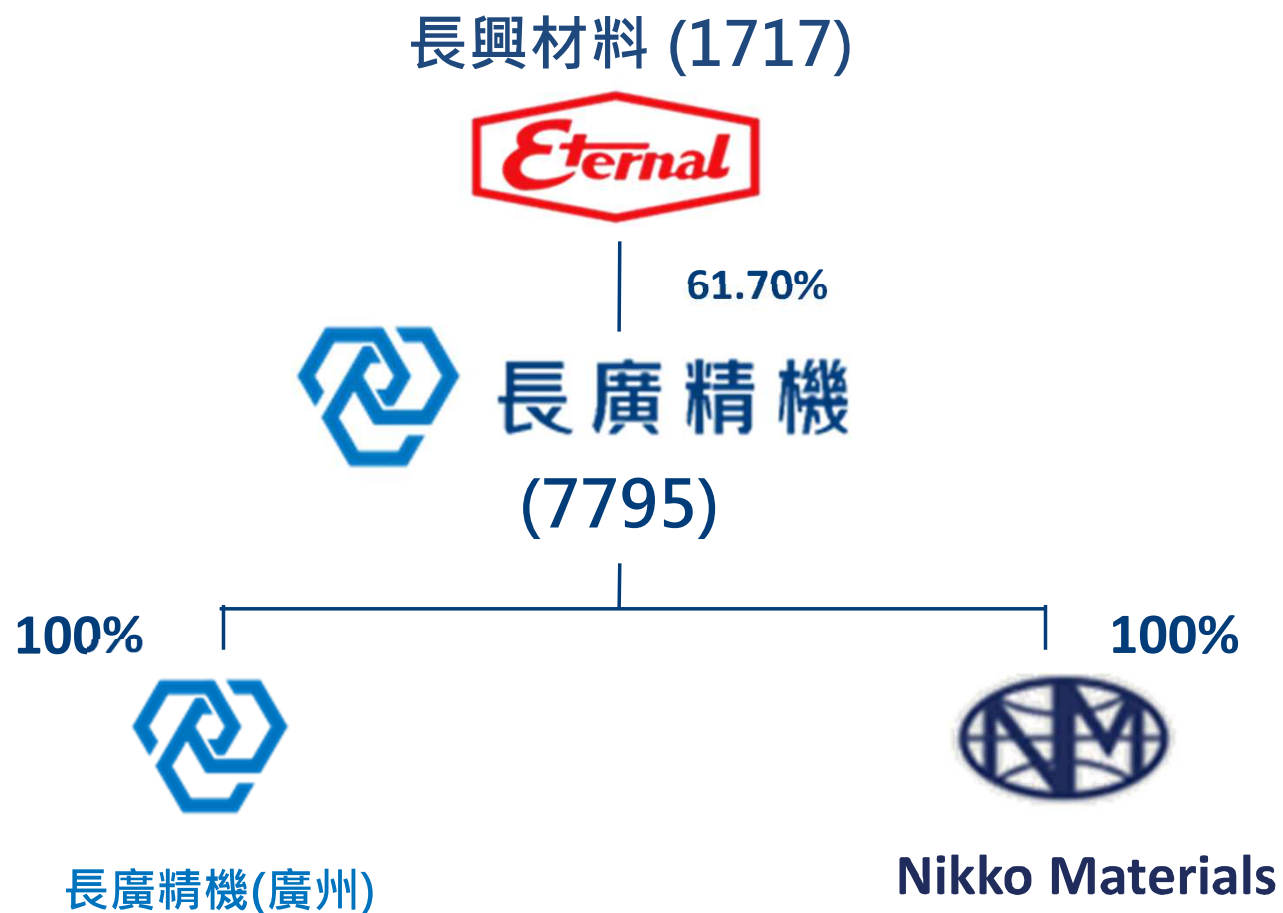
成立日：1997年9月30日
資本額：JPY 4.06億
社長：岩田和敏
員工數：173名

■ 長廣精機(廣州)有限公司

成立日：2023年9月1日
資本額：CNY 5,000萬(已完成增資)
總經理：林伯南
員工數：50名

◆ 合併集團員工共計
273名

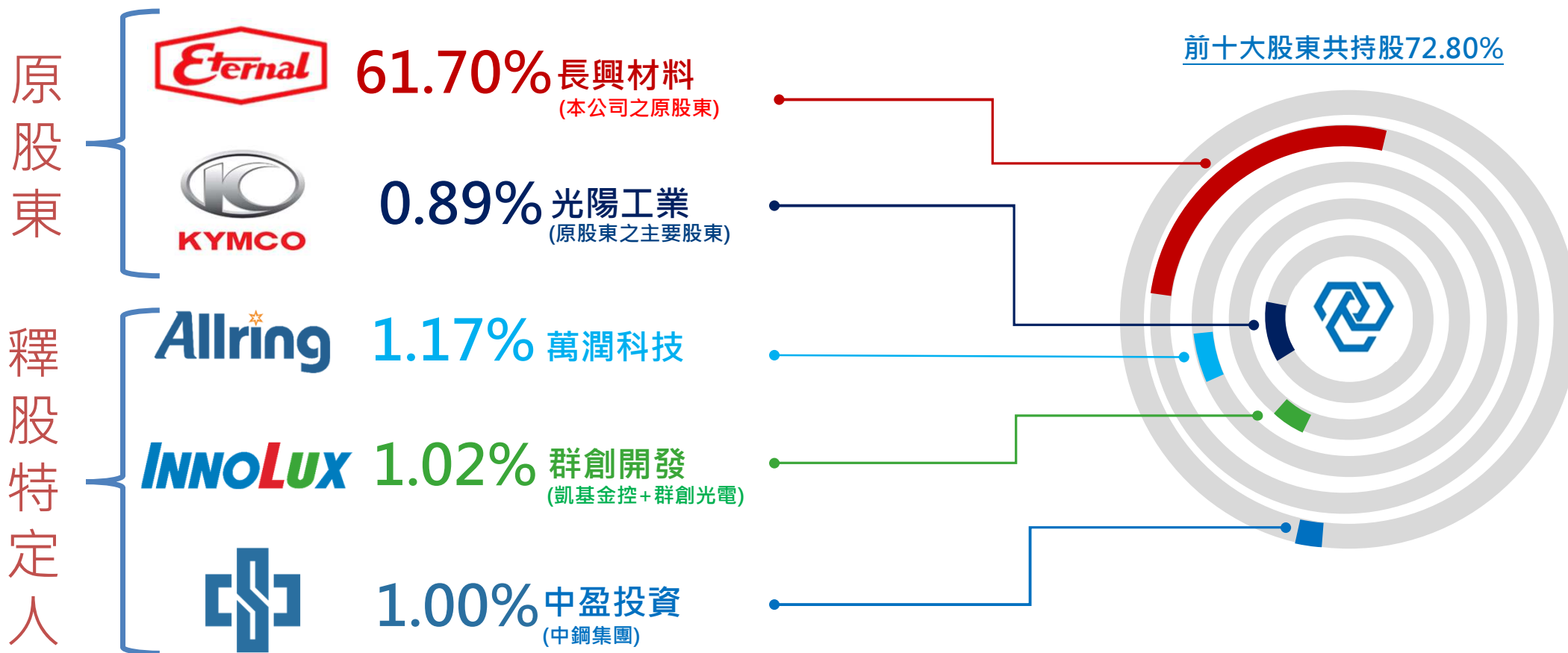
長興材料集團架構



長廣營運據點



長廣現有主要股東



目錄



01 長廣公司簡介

02 財務分析(2026H1-2025)

03 未來市場展望

04 產能與重大資本支出規劃

05 先進封裝產業發展與產品開發

長廣營收分析

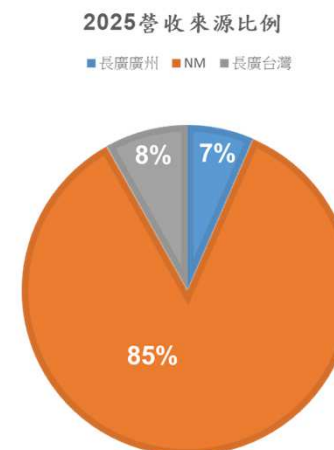
日本子公司設備銷售占主要營收來源

- ✓ 長廣營收包含「設備銷售」以及「承載膜」銷售，惟設備營收超過90%；
- ✓ 日本為高階產品組裝銷售中心
- ✓ 高雄大發廠為高階新技術設備展示、客戶服務與維修業務中心
- ✓ 中國廣州廠將提升組裝能力至二段式真空壓膜設備(中階產品)

長廣產品別-設備營收佔94%



長廣營收別-日本NM佔營收85%

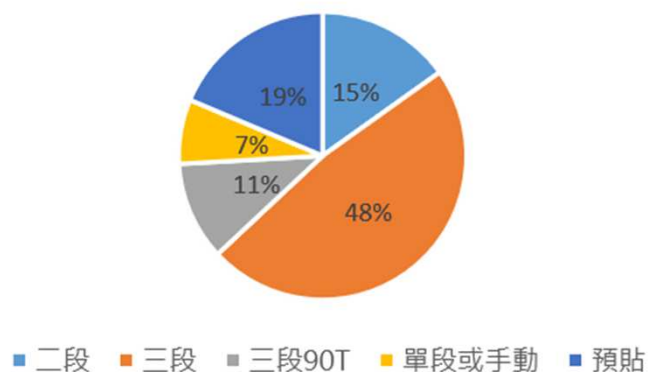


長廣設備銷售產品組合

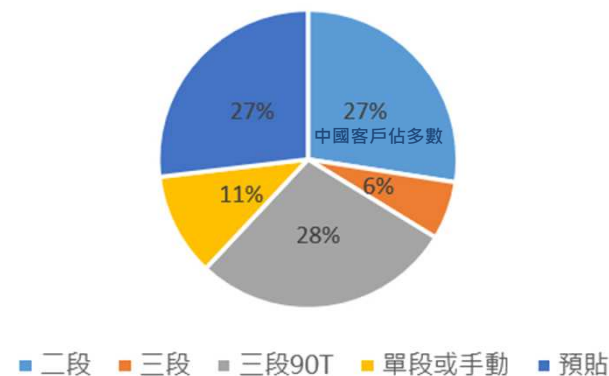
2026上半年高階產品出貨因組裝時間較長與配合客戶新廠裝機時程因素等，上半年高階出貨占比僅35%(vs 2025的59%)

預計3Q季末起台灣載板客戶高階設備出貨將大幅度提升，產品組合銷售將逐季恢復正常或更佳

2025年設備銷售額組合占比



2026年H1設備銷售額組合占比



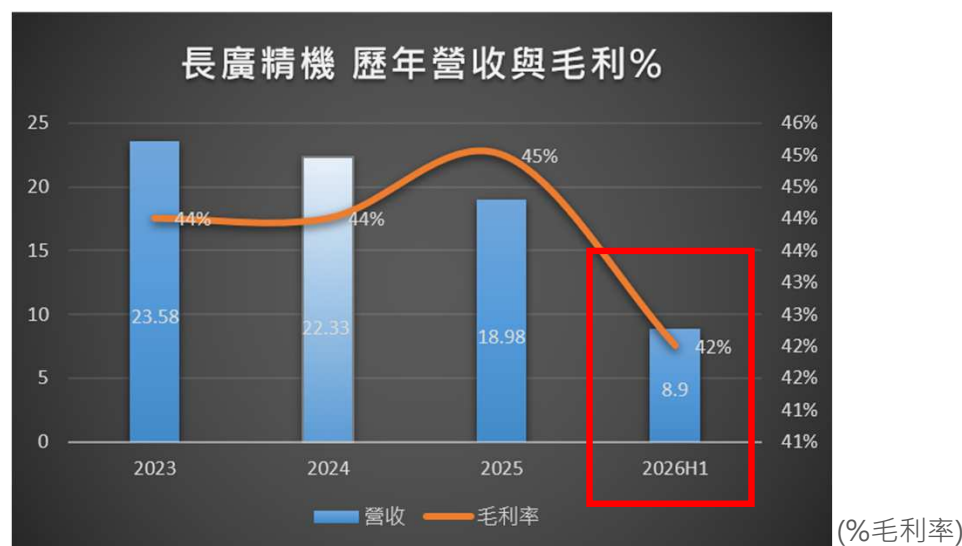
長廣合併銷售額與獲利

2026上半年因產品銷售組合與1Q認列員工認股費用等因素，營收、毛利率與淨利達成率偏低

預期2026下半年隨著大量設備集中出貨安裝，整體營運將較上半年有大幅度成長

長廣營運概況

(營收TWD億)



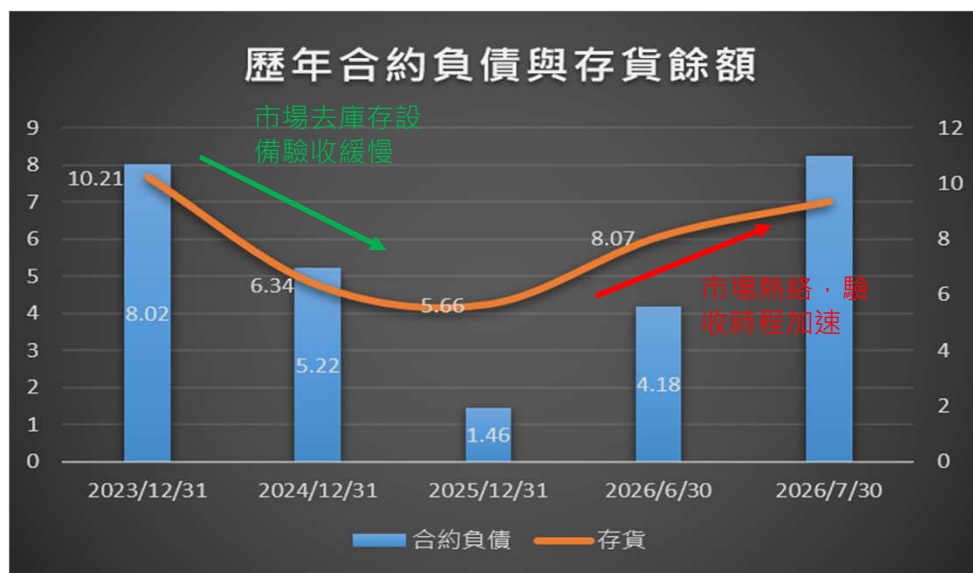
(營收TWD億)



長廣合併合約負債分析

2026年1-7月YOY營收仍有成長且7月底合約負債較年初已有倍數增加
(營收認列係沖銷合約負債)

(合約負債TWD億)



(存貨TWD億)

(營收TWD億)



(合約負債TWD億)

長廣合併損益費用分析

毛利率

2025: 45%、2026Q1: 39%、2026Q2: 44%

預估26年下半年高階產品組合出貨增加與價格調升影響下，毛利率將回復至2025年水準或更高一些

銷管研費用率

推銷費用約占營收10%左右

管理費用因第一季認列IPO認股費用較高，預估隨營收動能成長後，26年目標為營收10%以內
研發費用因各項先進封裝專案進行，費用較往年高，預估為營收1.0%-1.5%。

有效稅率

預估廣州廠、台灣總公司可虧轉盈假設下，有效稅率可由原近50%下降4%~5%。

目錄



01 長廣公司簡介

02 財務分析(2026H1-2025)

03 未來市場展望

04 產能與重大資本支出規劃

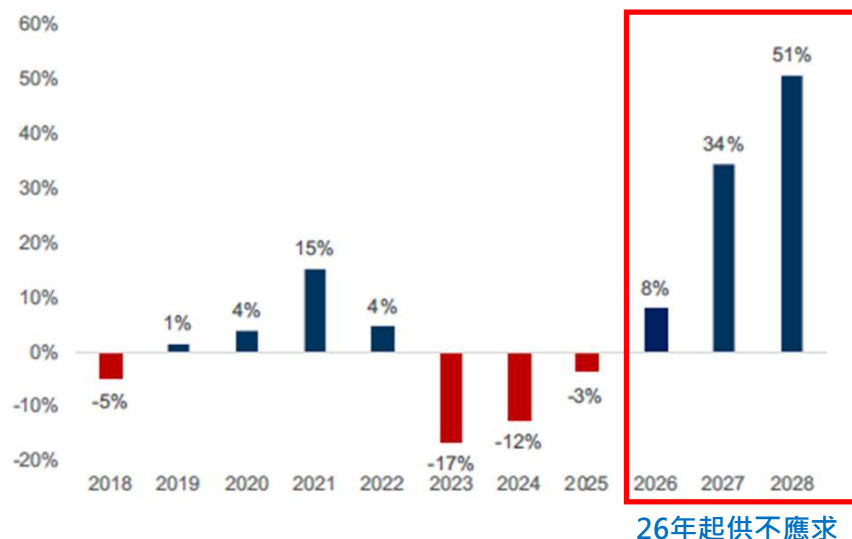
05 先進封裝產業發展與產品開發

AI Server、CPU 成為高階ABF最強成長動能

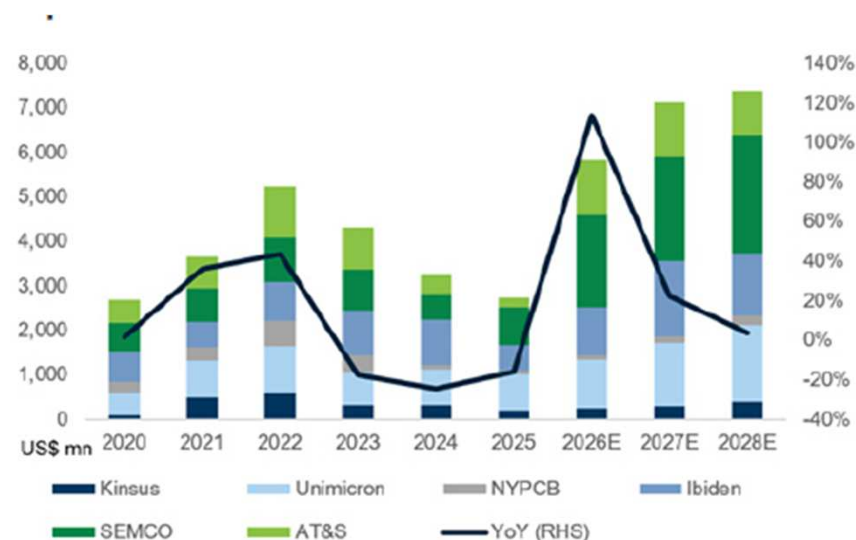
載板需求持續成長，資本支出將創新高

- ✓ AI與CPU需求推升載板用量成長，加上載板面積擴大、層數增加、製程良率下滑，三大因素疊加，進一步放大整體需求
- ✓ 預估2026–2028年全球主要載板廠資本支出將達120–150億美元
- ✓ 中高階ABF真空壓膜機需求滿載狀態將延續至2027年底，能見度更看至2029年，景氣展望樂觀

ABF 載板產業供需(D-S)



主要載板廠資本支出規劃



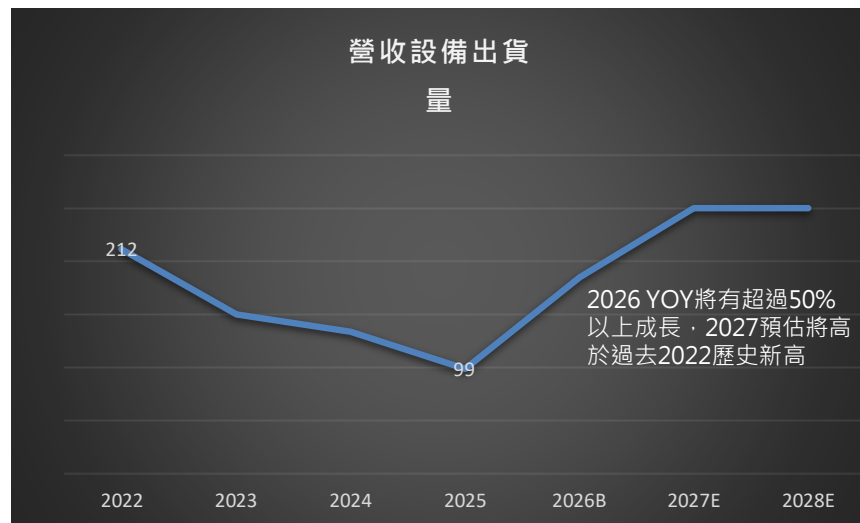
2026年下半年財報將逐季反應市場景氣

2026下半年營收出貨量將較上半年倍數成長

2026下半年高階設備出貨量占比將回升至約30% (約當2025年水準，惟分母是2026年預估總量)

2026下半年起全產品項價格調升約20%，預計年底安裝後反應

長廣真空壓膜機出貨台數



長廣高階設備出貨台數占比



目錄



01 長廣公司簡介

02 財務分析(2026H1-2025)

03 未來市場展望

04 產能與重大資本支出規劃

05 先進封裝產業發展與產品開發

2027-28短期產能擴充計畫

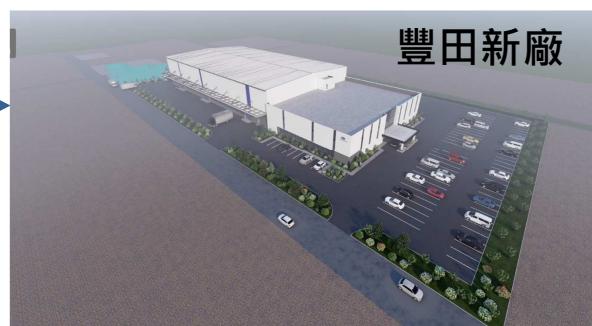
日本NM公司透過短期租賃廠房與契約組裝人員因應，租賃廠房有10台3段90T組裝空間

廣州公司下半年已完成人民幣2,000萬增資，採租賃廠房擴編組裝人力，並調整組裝銷售中階二段式設備為主

產能	日本NM		長廣廣州	
	設備台數	說明	設備台數	說明
目前月最大產能/台	18		4	單段以下設備為主
目標月最大產能/台	28	與車廠供應鏈廠商合作，逐季提升至2027年中達成	5	以兩段設備為主，預計2027農曆年後達成
目前最大年產能/台	216		48	
目標年最大產能/台	336		60	

日本豐田新廠遷廠規劃

- ✓ 目前正進行地目變更申請，預計2029年中完工
- ✓ 新廠將整合現有知立與兒玉兩廠，未來日本NM公司將僅有豐田廠與橫濱辦公室



- ✓ 產能規劃年產能規劃350台，並保留產線擴充彈性，以因應未來市場需求成長
- ✓ 土地(20,205平方公尺)廠房總投資預算約日圓93.62億元，後續視工程進度與規格調整仍有追加可能性
- ✓ 資金來源包含NM自有資金、台灣長廣資金貸與，以及當地銀行融資
- ✓ 整合組裝與研發中心，提升整體營運效率；同時鄰近車廠精密組裝加工聚落，有助強化專業人才招聘能量，並提升公司品牌形象與市場能見度。

高雄總公司購置新辦公室搬遷規劃

預計以自有資金投入約新台幣3.5億購置510坪市區辦公室用以營運總部搬遷，預計2027年中完成

1. 縮短集團溝通鏈

新址距長興集團總部僅10分鐘車程，強化跨部門協作與決策效率

2. 降低通勤負擔

現址位於大寮廠區，遷至市區可減少同仁每日通勤里程合計約300公里，提升工作生活品質減少範疇三排碳

3. 強化人才競爭力

市區據點擴大人才招聘範圍、提升留任率，同時提升企業形象與員工認同感

4. 貼近半導體客戶群

北高雄半導體聚落逐漸成形，客戶群集中於市區，可縮短拜訪與應變時間，深化客戶關係與服務品質



目錄



01 長廣公司簡介

02 財務分析(2026H1-2025)

03 未來市場展望

04 產能與重大資本支出規劃

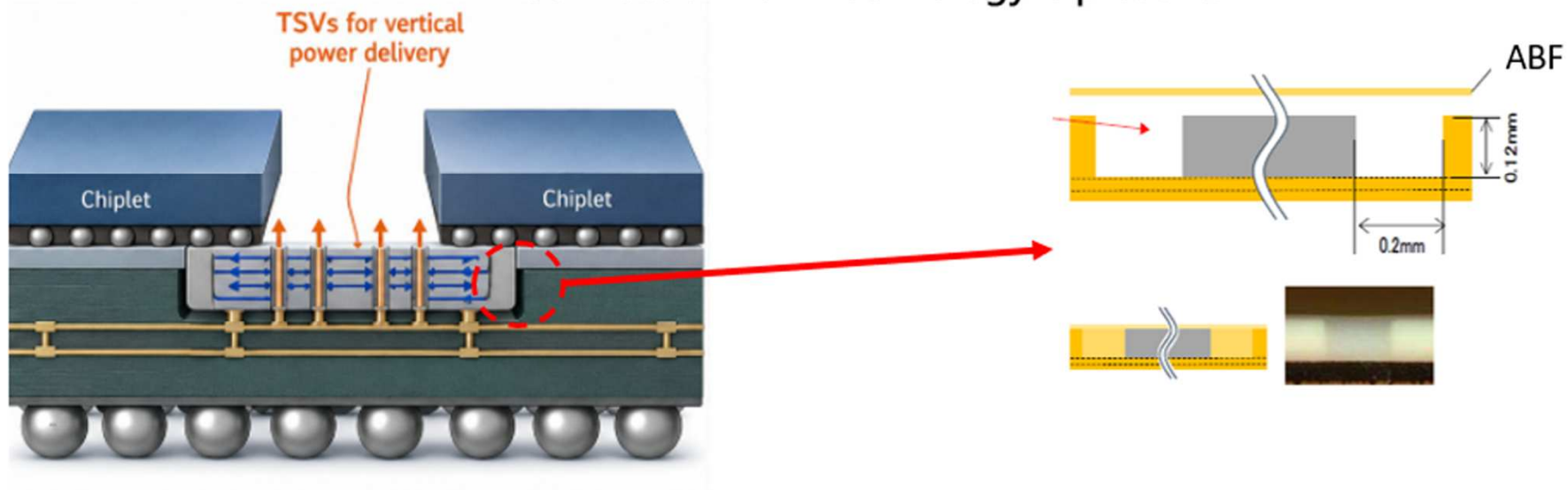
05 先進封裝產業發展與產品開發

現有IC載板設備開發-矽橋載板專用ABF真空壓膜機



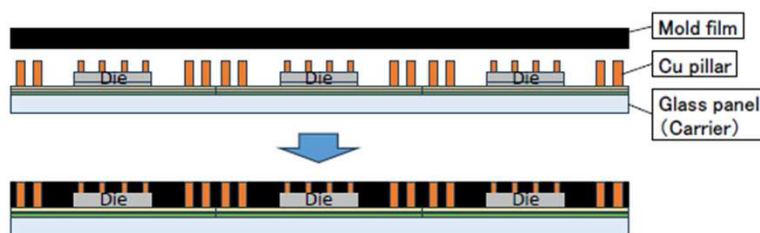
配合以美國CPU大廠與日系載板廠為主之客戶開發矽橋載板/部品內藏 真空壓膜機，預計2027年開始出貨

Embedding the bridging silicon(or component) with build-up film material(ABF)
Our Vacuum lam Technology is present!

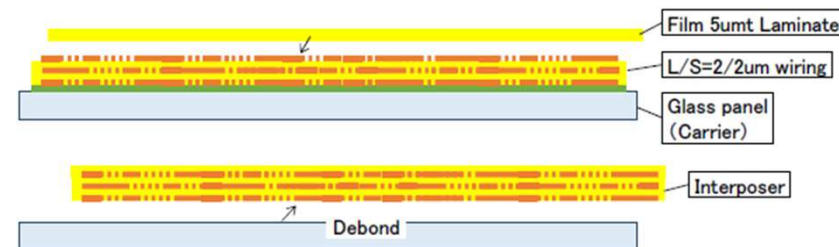


玻璃基板與承載玻璃設備開發

- ✓ 玻璃基板於2022-2024年配合美國廠商已進行0.1mm~1.8mm厚度傳送與三段真空壓膜測試完成，目前尚待日本兩家玻璃加工廠商針對玻璃加工與檢驗進行測試開發
- ✓ 配合台灣OSAT廠、日商材料廠與終端美商對承載玻璃先進封裝用於FOPLP與RDL中介層真空壓膜製程

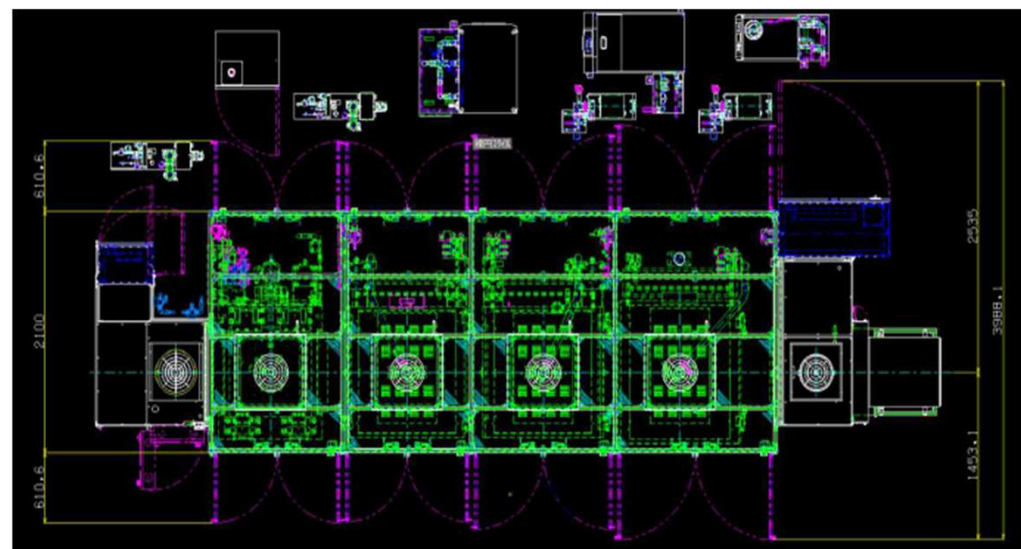


• 微細線路中介層 (Interposer) 製程開發
正在共同開發載有 $L/S = 2/2 \mu m$ 微細線路的薄型中介層製造製程



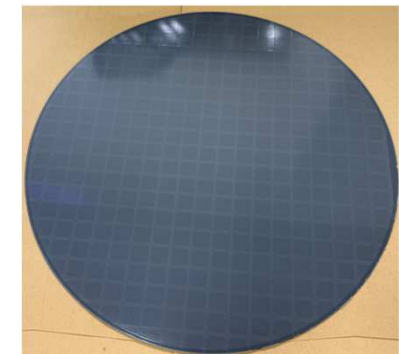
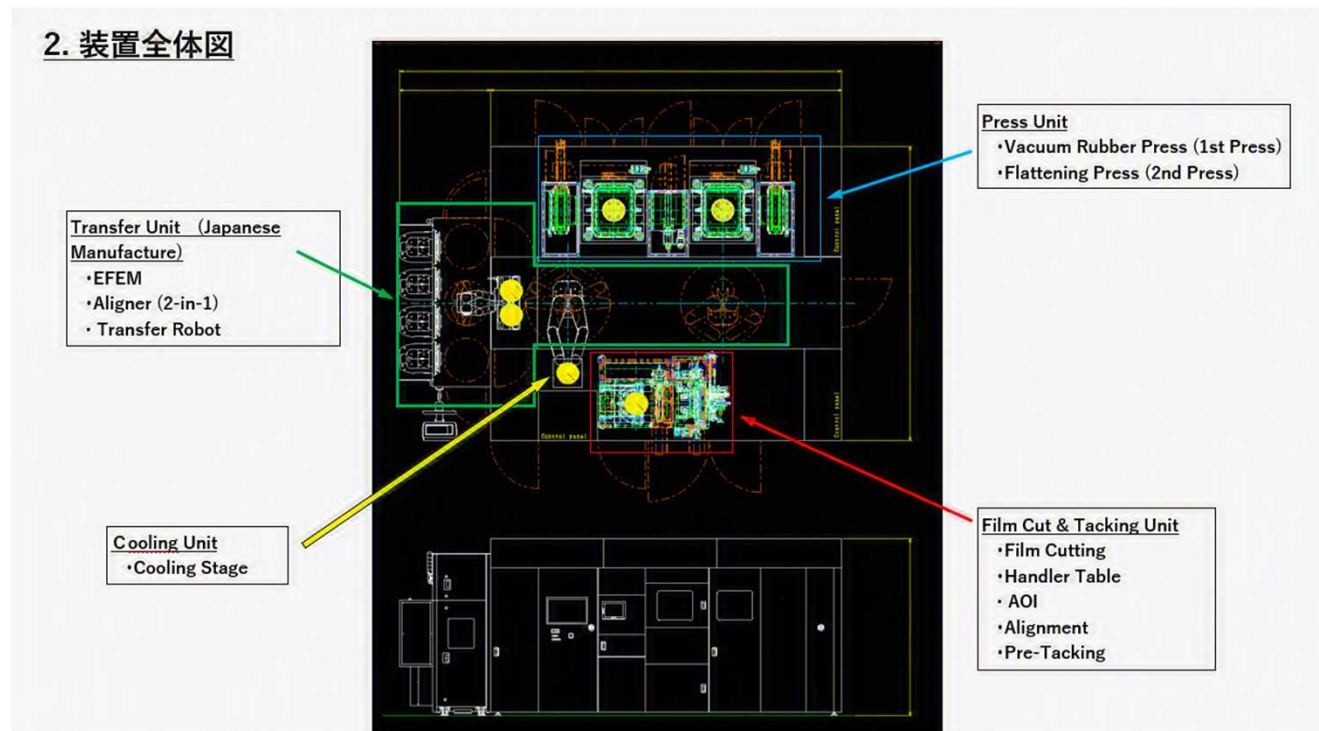
四段式真空壓膜機

參與日商Resonac Joint 3計畫開發四段式真空壓膜機，開發未來材料用於先進封裝真空壓膜平整度需求



晶圓真空壓膜機

持續為台灣廠商設計開發晶圓ABF真空貼膜設備，預計於2027第一季底完成測試機





長廣精機

Thank You

ETERNAL PRECISION MECHANICS